

SCHEDA TECNICA ZM-R720

Sistema di Rework per Package Array, LED e BGA

Generalità :

Sistema automatico per la rilavorazione di schede SMT che montano dai micro chip al grid array di grandi dimensioni e più complesso. Il pannello touch screen e lo schermo in alta risoluzione agevolano il lavoro dell'operatore, mentre un sistema di controllo automatico della testa di rifusione protegge i circuiti più delicati. I cicli automatici di rifusione per la saldatura e dissaldatura, sono in grado di riprodurre le condizioni ideali per la salvaguardia dei circuiti e dei componenti più sensibili. La telecamera HD è motorizzata ed il suo posizionamento è sincronizzato con la testa di rifusione.



Caratteristiche di base :

- Testa di reflow ad aria calda
- Preriscaldamento doppio (aria e IR)
- Temperatura ultra controllata
- Precisione sensore 2-3°C
- Allineamento ottico di precisione
- Telecamera HD 2Mp motorizzata
- Ingrandimento 5X-50X
- Touch screen ad alta risoluzione
- Posizionamento automatico
- Saldatura e dissaldatura



Principali Specifiche Tecniche:

Alimentazione / Potenza assorbita	220VAC 50/60Hz / Max 5800W
Potenza dei riscaldatori ad aria	Superiore 1200W , inferiore 1200W
Potenza del pre-riscaldatore IR	2700W IR a riscaldamento rapido
Temperatura dell'aria calda	400°C max
Posizionamento	Portaschede anti warp, puntatore laser
Precisione nell'allineamento	Tipicamente 0,02 mm
Min / Max dimensione della scheda	6 x 6 mm / 410 x 370 mm
Adatta per componenti	BGA, QGN, SCP, POP, QFN, LED, micro SMD
Min / Max dimensione dei componenti	0.6 x 0.6 mm / 50 x 50 mm ***
Dimensioni e peso	640(L) x 630(P) x 920(H) mm , 83 kg

*** con feeder e testine di prelievo opzionali può lavorare anche con i micro chip sino a un min. di 0.4x0.2mm